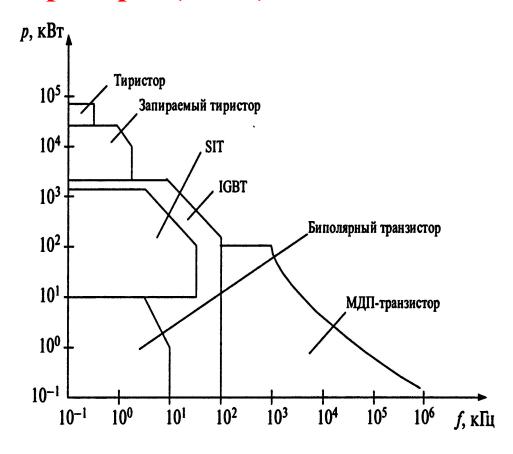
Силовые полупроводниковые приборы (СПП)

Наиболее широко используемые в настоящее время СПП:

- IGBT;
- МДП-транзистор;
- биполярный транзистор;
- SIT;
- тиристор;
- симистор;
- запираемый тиристор.

Выпускаемые промышленностью отдельные конкретные типы всех перечисленных выше транзисторов и тиристоров имеют высокие значения максимально допустимых напряжений (сотни вольт) и максимально допустимых токов (сотни ампер).

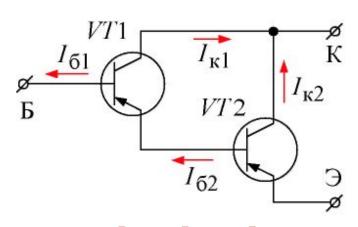


Из анализа сравнительной оценки СПП видно:

- 1.Некоторые типы тиристоров и IJBT модулей имеют **Uобр.** доп. >1000В и Ia > 1000А
- **2.** Максимальную частоту коммутации **f**к имеют **МДП** транзисторы более 1-го МГц;
- 3. В настоящее время IJBT и МДП- транзисторы вытесняют БТ и SIT транзисторы.

Силовые биполярные

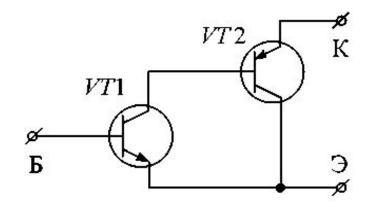
Транзисторы1. Составной транзистор это соединение двух и более транзисторов, эквивалентных одному транзистору, но с большим коэффициентом усиления.

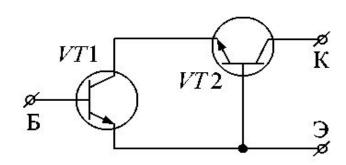


$$\beta_{_{9KB}} = \frac{I_{_{K}}}{I_{_{61}}} = \frac{I_{_{K1}} + I_{_{K2}}}{I_{_{61}}} = \beta_1 + \beta_2 + \beta_1\beta_2;$$

$$I_{K1} = \beta_1 I_{61}$$
 $I_{K2} = \beta_2 (I_{61} + \beta_1 I_{61})$

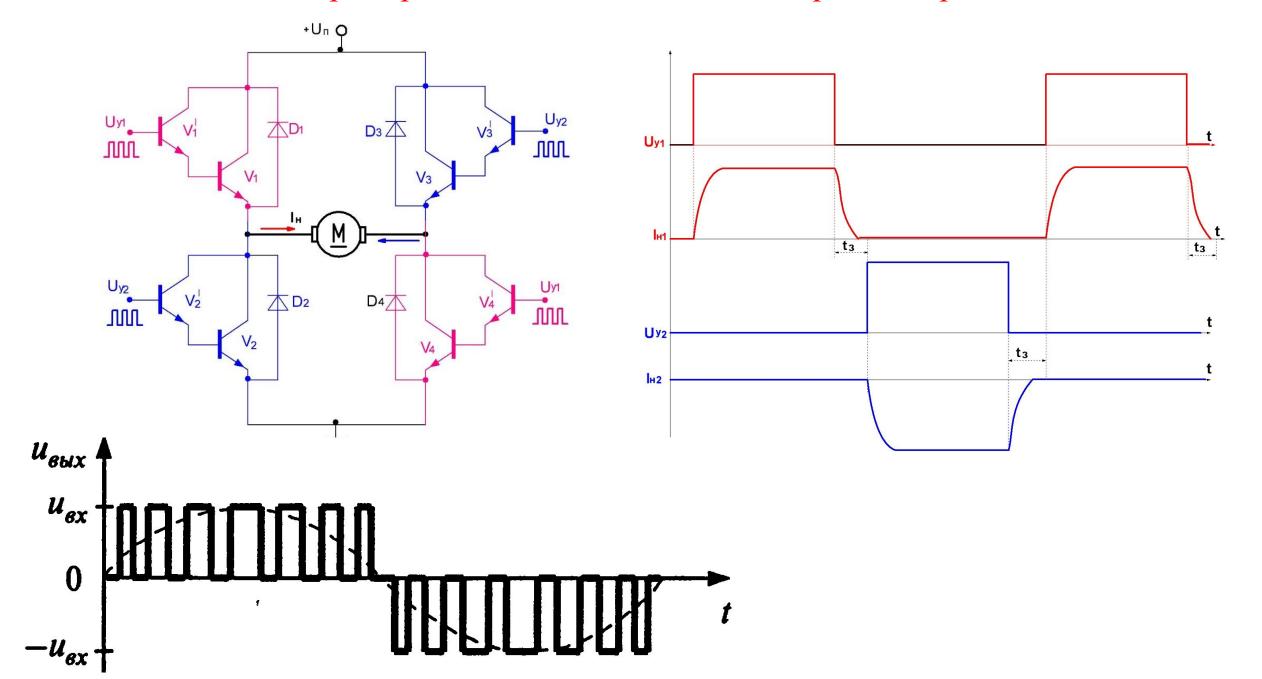
$$R_{\text{BX}} = R_{\text{BX}1} + R_{\text{BX}2}(\beta_1 + 1)$$
 $R_{\text{BBIX}} = R_{\text{BBIX}1} \parallel R_{\text{BBIX}2}$

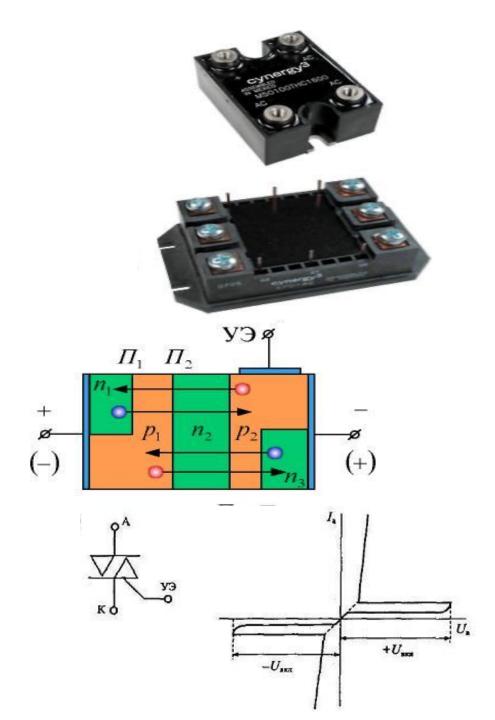




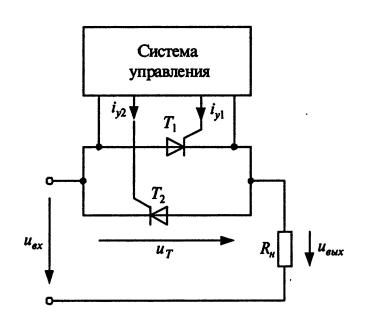
$$m{eta}_{_{\mathrm{ЭКВ.}}}pprox m{eta}_{_{\mathbf{1.}}}m{eta}_{_{\mathbf{2.}}}$$
; При $m{eta}_{_{\mathbf{1.}}}=\mathbf{100}$, $m{eta}_{_{\mathbf{2.}}}=\mathbf{10}$; $m{eta}_{_{_{\mathrm{ЭКВ.}}}}=\mathbf{1000}$ $m{I}_{_{\mathrm{BX}}}=m{I}_{\mathrm{B1}}=m{I}_{_{\mathrm{H}}}m{/}_{m{eta}_{_{\mathrm{ЭКВ}}}}$ При $m{I}_{_{\mathrm{K2}}}=\mathbf{100A}$; $m{I}_{\mathrm{61}}=\mathbf{100}/\mathbf{1000}=\mathbf{0}$,1A

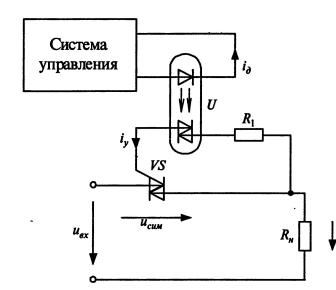
Примеры использования силовых транзисторов

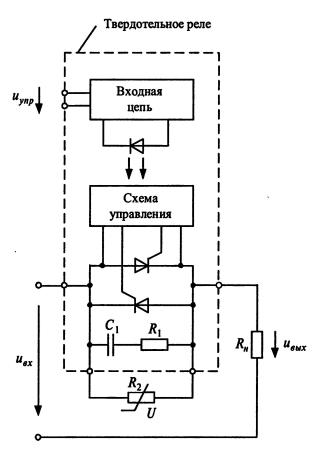




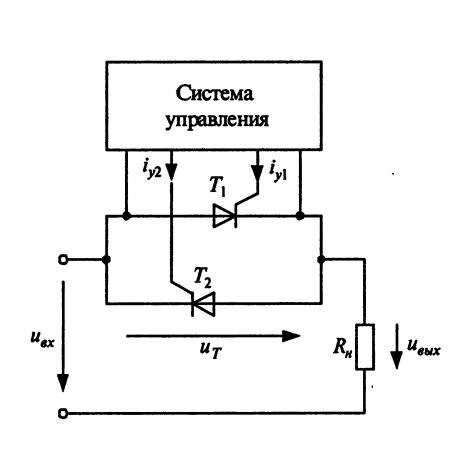
Силовые тиристоры

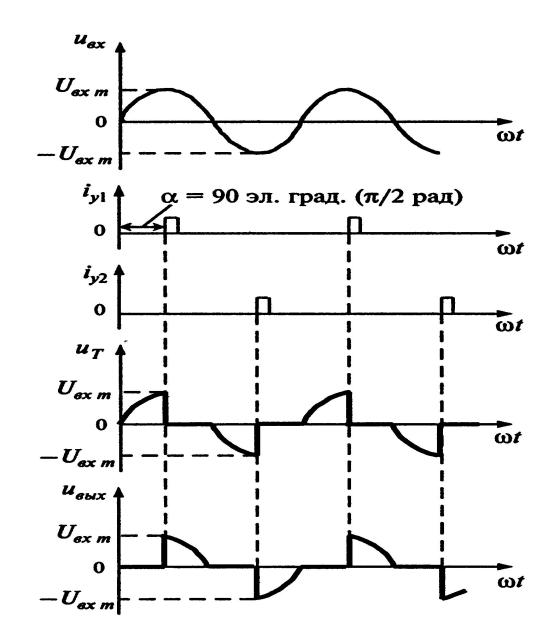




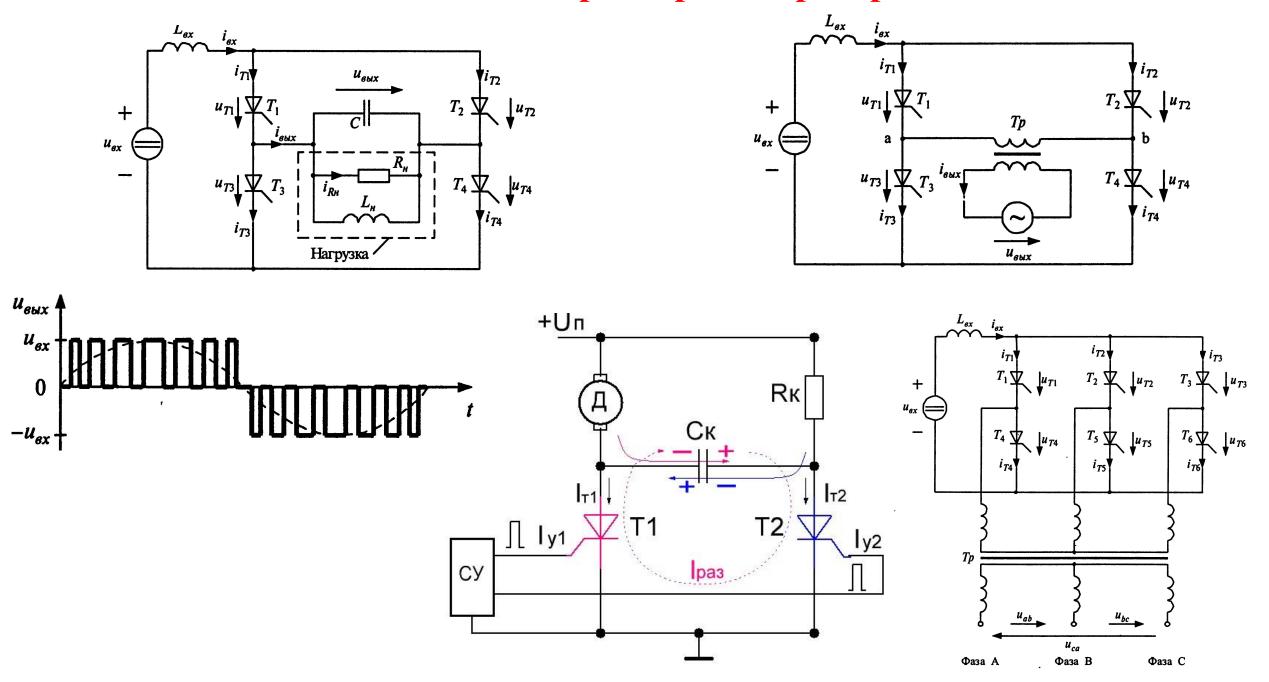


Примеры использования силовых тиристоров

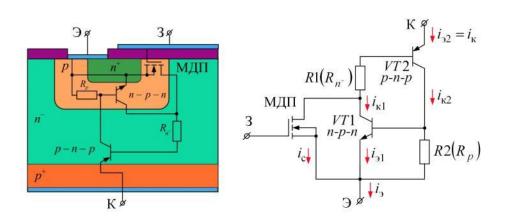




Мостовые схемы тиристорных преобразователей



БТ с изолированным затвором (БТИЗ) или (IJBT транзисторы)



$$I_{\vartheta} = I_{\kappa 1} + I_{\kappa 2} + I_{c}$$
 $I_{\kappa 1} = I_{\vartheta 1} \alpha_{1}$; $I_{\kappa 2} = I_{\vartheta 2} \alpha_{2}$

$$I_{c} = I_{3}(1 - \alpha_{1} - \alpha_{2}) \approx SU_{3}$$

$$I_{K} \approx I_{9} = \frac{SU_{3}}{1 - (\alpha_{1} + \alpha_{2})} = S_{9}U_{3} S_{9} = \frac{S}{1 - (\alpha_{1} + \alpha_{2})}$$

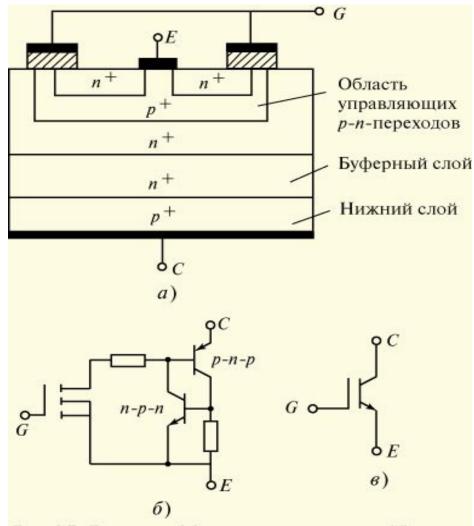
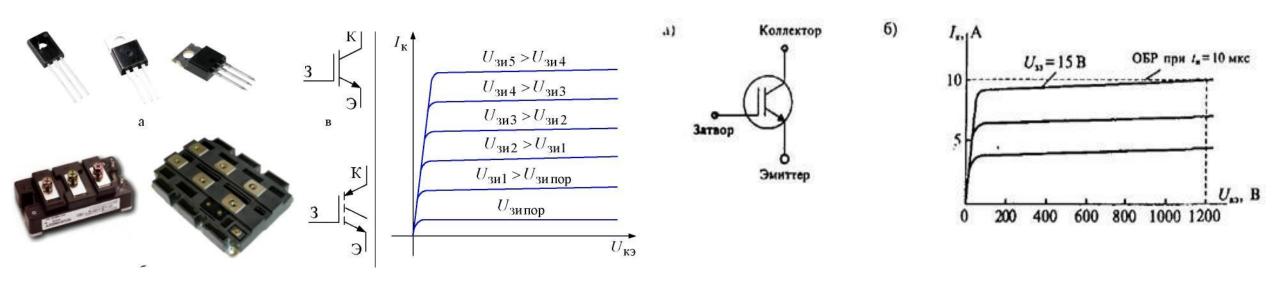
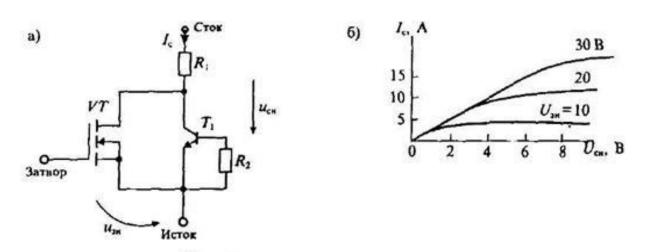
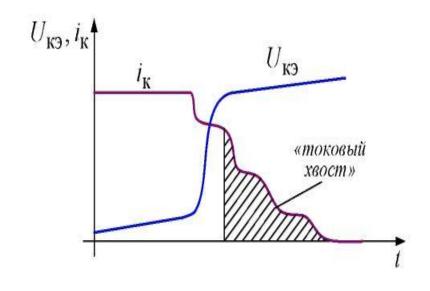


Рис. 6.7. Структура (a), эквивалентная схема (δ) и символ (ϵ) биполярного транзистора с изолированным затвором

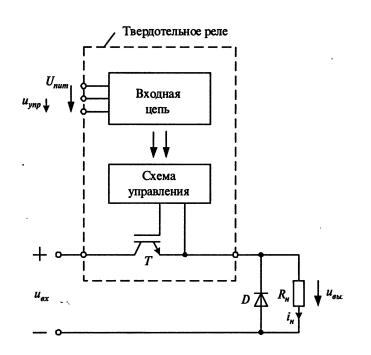
ІЈВТ транзисторы и основные их характеристики

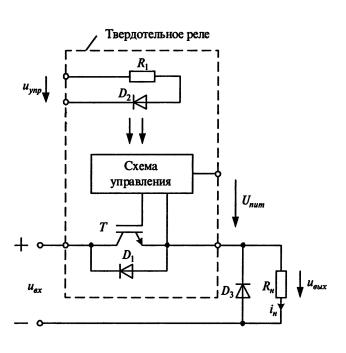


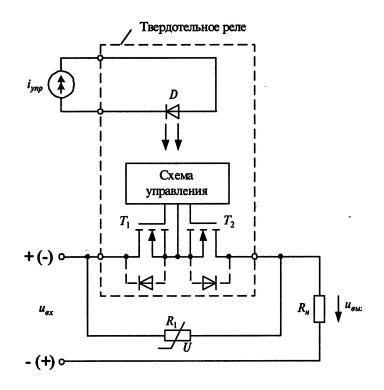




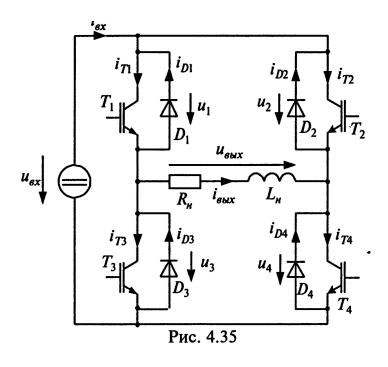
Примеры схем на IJBT транзисторах (твёрдотельные реле)

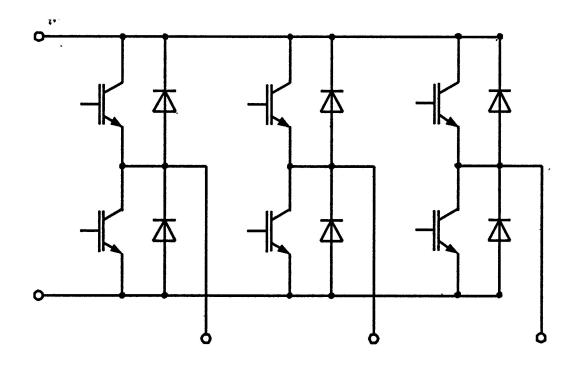






Примеры использования IJBT модулей

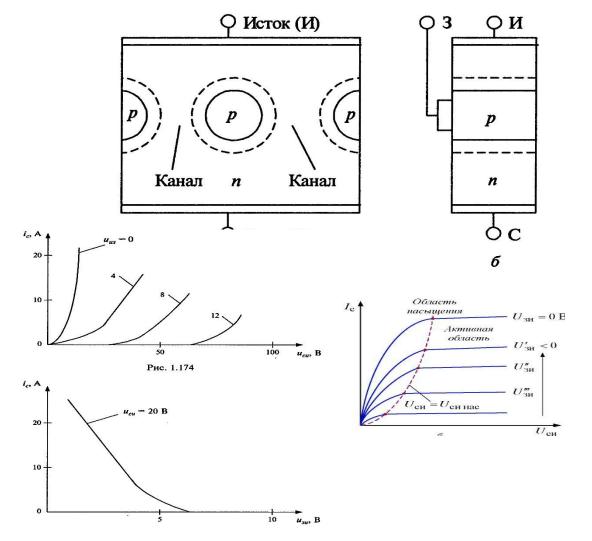


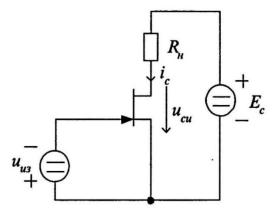


SIT- транзистор со статической индукцией

Аббревиатура SIT соответствует английскому названию транзистора — Static Induction Transistor.

Это многоканальный ПТ с управляющим p-n переходом (N> 1000) с вертикальной структурой





Особенности работы SIT:

- 1. Uси мало, т.к. мала длинна канала, поэтому оно не влияет на характер изменения Ic;
- 2. При увеличении Ucu ток Ic возрастает (Uзи =const)
- 3. Стокозатворная ВАХ отличается протяжёнными линейными участками, поэтому SIT хорошо работают в УЗЧ большой мощности и в ключевом режиме.
- 4. SIT могут использоваться и в биполярном режиме, когда Uзи < 0, при этом p-n переход открывается и SITпереходит в режим БТ. В этом режиме при открытом SIT Ucи –мало при больших токах Ic, но быстродействие снижается.

Заключение

На сегодняшний день IBGT как класс приборов силовой электроники занимает и будет занимать доминирующее положение для диапазона мощностей от единиц киловатт до единиц мегаватт. Дальнейшее развитие IGBT связано с требованиями рынка и будет идти по пути:

- •повышения диапазона предельных коммутируемых токов и напряжений (единицы килоампер, 5-7 кВ);
- •повышения быстродействия;
- •повышения стойкости к перегрузкам и аварийным режимам;
- •снижения прямого падения напряжения;
- •разработка новых структур с плотностями токов, приближающихся к тиристорным;
- •развития "интеллектуальных" IGBТмодулей (с встроенными функциями диагностики и защит) ;
- •создания новых высоконадёжных корпусов, в том числе с использованием ММС (AlSiC);
- •повышения частоты и снижение потерь SiC быстро восстанавливающихся обратных диодов;
- •применения прямого водяного охлаждения для исключения соединения основание охладитель.